資料　3
（第 50 回監視円卓会議）

安定器分離処理設備工事の進捗状況について

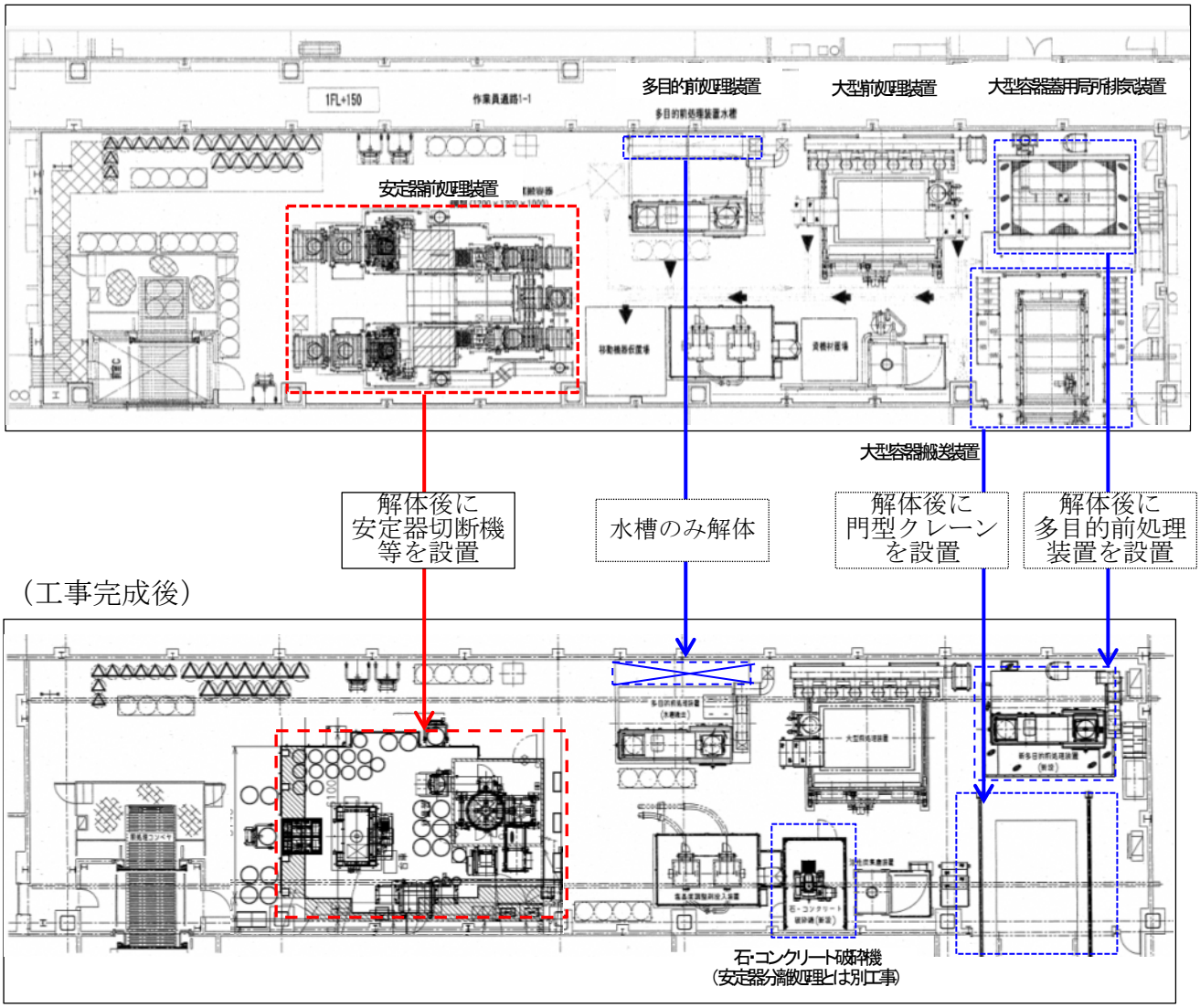
安定器の分離処理※の設備は５月に現地工事に着手し、今年度内の稼働開始に向け概ね予定どおりに工事が進捗しておりますので、現在の状況を報告します。

※　安定器の分離処理とは
廃安定器の PCB を含むコンデンサー内蔵部とそれ以外のトランス内蔵部とに分割し、
・ コンデンサー内蔵部:プラズマ溶融分解処理
・ トランス内蔵部　:プラズマ溶融分解以外の処理方法にて処理
とすることにより、PCB を含む廃安定器の効率的な処理の促進を図るもの。

○　９月現在の状況
既設設備の解体等の工事を完了（下図の青破線部分）

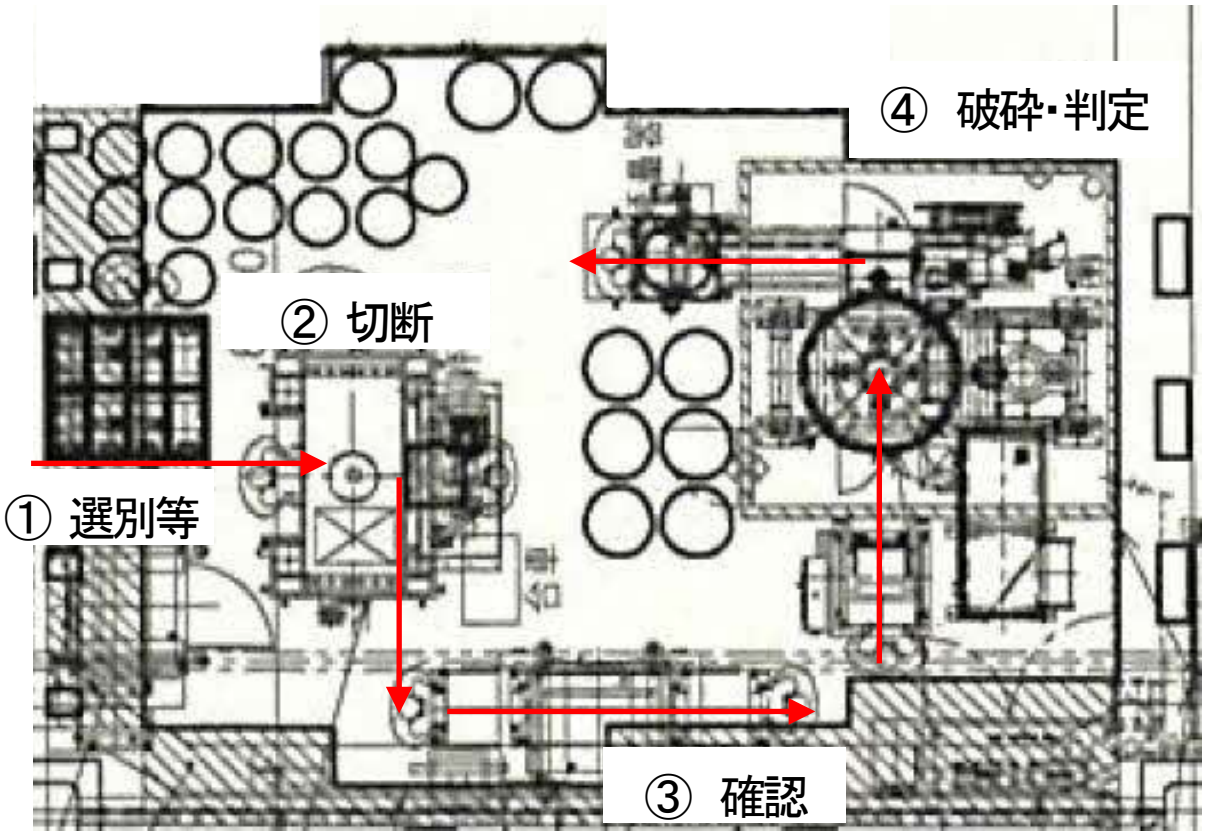
○　今後の予定
安定器前処理設備を解体後に安定器の切断装置等の設置工事を行う予定（下図の赤破線部分）

（工事前）



参考：安定器分離処理の作業イメージ

（前ページ赤破線部分の拡大図・矢印は処理対象物の流れ）



作業工程の概要

① 選別等

処理対象外安定器分別、仕分け

寸法確認・切断位置マーキング（必要に応じてＸ線透過装置で確認）

② 切断

①でマーキングした位置で切断機により安定器を切断

③ 確認

Ｘ線透過装置でコンデンサーの混入を確認

④ 破砕・判定

トランス内蔵部を破砕後にＰＣＢ濃度確認用サンプルを採取